



·利尔达主办“新物联趋势，Wi-SUN 广域大规模物联网论坛”，并推出 Wi-SUN 射频模块 WS7300 及系列产品

Wi-SUN 近年备受瞩目，以其技术优势被广泛应用在智能电表及家庭智能能源管理领域。

3月31日，由Wi-SUN联盟、环球表计以及利尔达等会员联合组织的“新物联趋势，Wi-SUN广域大规模物联网论坛”在线上成功举办，5000多人次参与。分享嘉宾包括技术专家（中国科学院）、芯片（深通芯）、模组（利尔达）、智能电表（粒合）与智能路灯（Itron 埃创）应用、认证实验室（百佳泰）等，通过技术验证与实际应用案例探讨Wi-SUN在多项公用事业领域的发展，呈现Wi-SUN完善的生态体系。

同时利尔达在会上发布满足世界各国ISM频段的Wi-SUN射频模块WS7300及系列产品。WS7300-915是一款天线外置型小型表面贴装Wi-SUN模块，该模块搭载了深通芯的Wi-SUN芯片VC7300，该芯片最大传输速率可达400Kbps；Sub-GHz频段，适用全球各频段；最大发射功率20dBm；内置AES256硬件加密，安全性高。



该系列模组从用户痛点出发，最大程度上解决了广域大规模网络讯号丢失与拥堵、噪声干扰、距离短、遮蔽、电池寿命不足等问题。

环球表计指出根据权威研究公司预计，全球IEEE 802.15.4芯片模块出货量将在未来五年内翻三番，达到10亿。其中IPv6协议增长率最快。凭借端到端的IP可寻址能力、广覆盖、安全性和可扩展性高，Wi-SUN正在全球范围的公用事业网络和智慧城市基础设施设备中快速崛起！